

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司向建设银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度具体事宜

鉴于福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展和生产经营需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请人民币 5000 万元的授信额度,授信期限以银行审批为准。

公司将新网科技有限公司 50%、中山市中达小额贷款有限责任公司 30%、青岛融佳安全印务有限公司 100%、厦门达华商业保理有限公司 100%股权作质押。

根据公司《股东大会、董事会和董事长决策权限管理制度》,本次申请授信事项在董事长决策范围内,无需提交董事会、股东大会审议,亦不构成关联交易,董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

二、对公司的影响

经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月二十七日